

S-Uk-I

ISDN S0 – Uk0 Interface



Allgemein

Das S-Uk-I gehört zur Keytronix DIS-Plus Familie und dient zur Erhöhung der Reichweiten von Teilnehmeranschlussleitungen für ISDN-Anschlüsse. Damit können ISDN S0 Schnittstellen über die übliche Länge hinaus gehend verlängert werden.

Dabei wird eine S0 Schnittstelle auf eine Uk0 Schnittstelle umgewandelt. Mit dieser Uk0 Schnittstelle können Entfernungen von 6 km bei 0,4 mm überbrückt werden.

An der Remote Seite kann ein beliebiger ISDN NT mit oder ohne Fernspeisung eingesetzt werden.

Das S-Uk-I ist als 1-Port oder 2-Port Variante erhältlich.

Zwei verschiedene Gehäuse stehen für den Einbau der S-Uk-I zur Auswahl:

Für Einzellösungen bietet sich das Tischgehäuse, TG-1 an.

Bei Anwendungen mit höheren Packungsdichten kann das 19" Gehäuse 19R3 verwendet werden.

Das 19R3 dient zur Aufnahme von bis zu 3 S-Uk-I oder Analog Booster Baugruppen.

Somit kann auch ein gemischter Betrieb in einem 19" Gehäuse realisiert werden.

Features

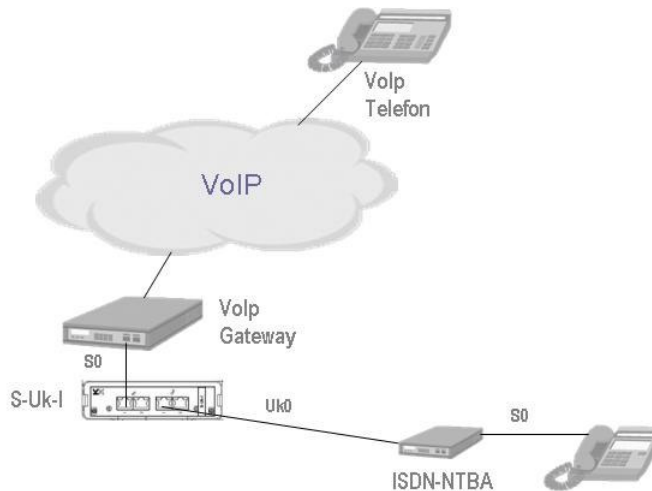
- 1 bzw. 2 S0 Interface/s
- 1 bzw. 2 Uk0 Interface/s
- Line Code 2B1Q
- Überwachung der Übertragungsstrecke / Anzeige über LED
- Automatische Takterkennung / Umschaltung
- Alarmkontakt zur Überwachung der Betriebsspannung

S-Uk-I

ISDN S0 – Uk0 Interface

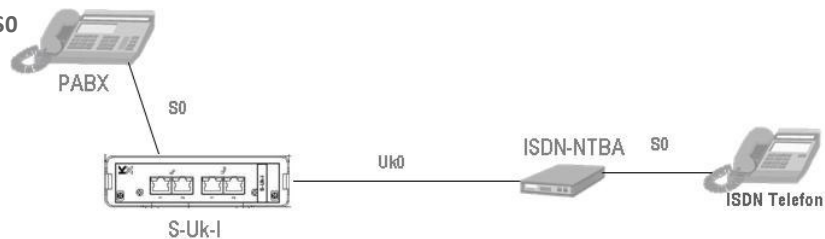
Applikation

S-Uk-I als Verlängerung der S0 nach einem VoIP Gateway



Applikation

S-Uk-I als Verlängerung der S0 einer Telefonanlage



Spezifikation

S0 Interface

- Übertragungsgeschwindigkeit: 192kbit/s
- Übertragungsverfahren: S0 nach I.430
- TE Betriebsart
- Anschluss: RJ-45 Buchse

Uk0 Interface

- ISDN Basis-Rate mit 2B1Q gemäß ETSI TS 102080
- Fernspeisung: 95V DC +/- 5%
- automatische Abschaltung bei Überlastung
- Anschluss: RJ-45 Buchse

Stromversorgung

- Spannungsversorgung: 230 V AC
- Schutzklasse I

Mechanik

- Abmessungen der Baugruppe: 160 mm x 100 mm
- Abmessungen des TG-1:
Höhe: 40mm Breite: 145mm Tiefe: 260mm
- Abmessungen des 19R3:
Höhe: 44mm Breite: 483mm Tiefe: 306mm

Umgebungsbedingungen:

- Umgebungstemperatur:
im Betrieb: 0°C bis + 50°C
Transport und Lagerung: -20°C bis + 70°C
- relative Luftfeuchte: <80%, nicht kondensierend